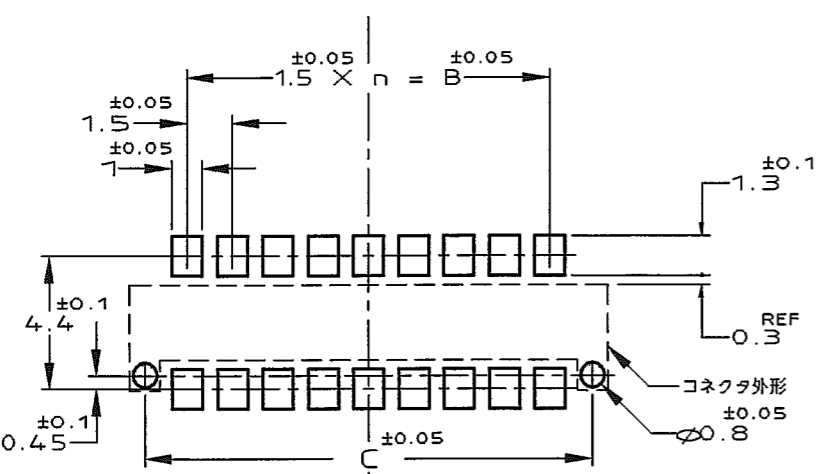
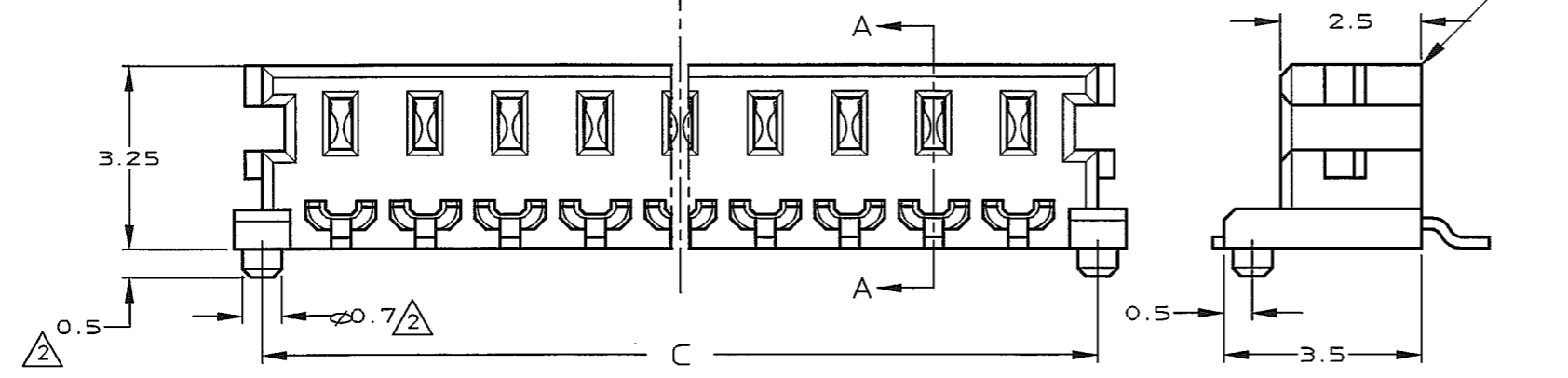
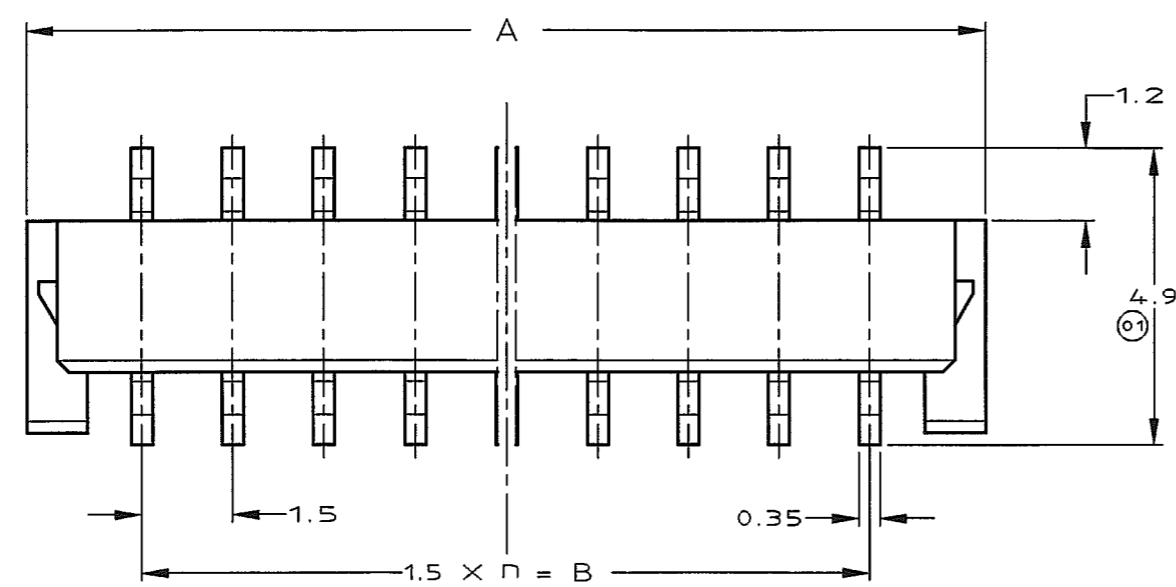


NUMBER 917570
METRIC

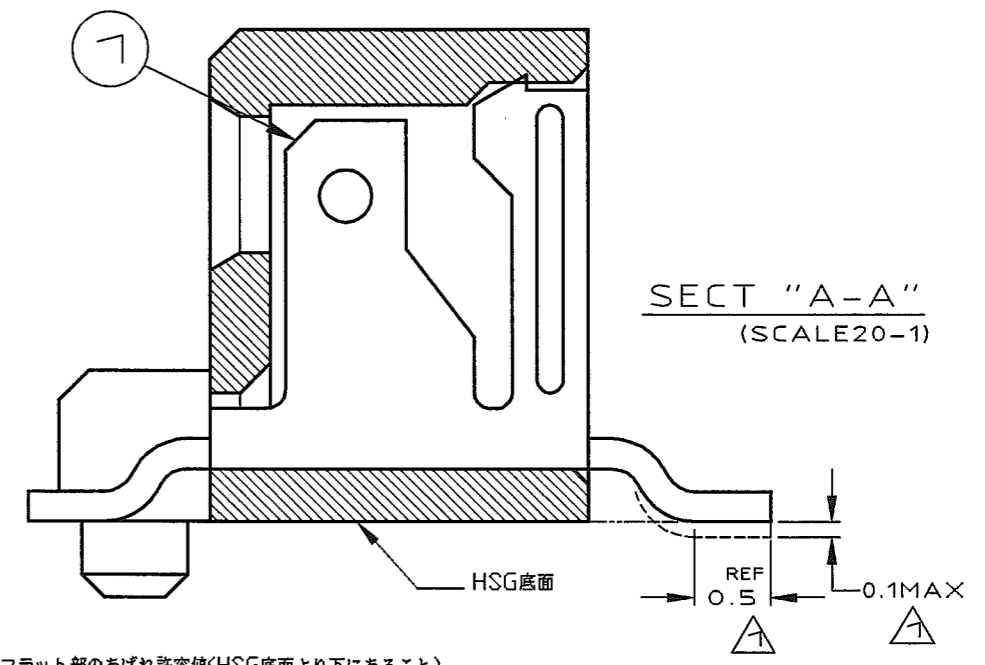
PRINT DIST
単位: 概 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT



推奨基板寸法
RECOMMENDED P.C.BOARD DIM.
(VIEW FROM CONN.SIDE.)

4 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

	C	n	B	A	極数 Pos.	PART NUMBER
	7.3	3	4.5	8.3	4	917570-4
	11.8	6	9	12.8	7	917570-7
	14.8	8	12	15.8	9	917570-9
4 OBSOLETE	17.8	10	15	18.8	11	4-917570-1
	19.3	11	16.5	20.3	12	4-917570-2
ボスなし NO BOSS	7.3	3	4.5	8.3	4	6-917570-4
	11.8	6	9	12.8	7	6-917570-7
	14.8	8	12	15.8	9	6-917570-9
	17.8	10	15	18.8	11	7-917570-1
	19.3	11	16.5	20.3	12	7-917570-2
	7.3	3	4.5	8.3	4	8-917570-4
	11.8	6	9	12.8	7	8-917570-7
	14.8	8	12	15.8	9	8-917570-9
	17.8	10	15	18.8	11	9-917570-1



注記
 △ タインフラット部のあばれ許容値(HSG底面より下にあること)
 △ 6-917570-X, 7-917570-X, 8-917570-X 及び 9-917570-X はボスなし
 △ 8-917570-X 及び 9-917570-X は金めっきタイプ、他は半田めっきタイプ
 NOTE
 △ FLATNESS OF TINE SOLDER SURFACE.
 △ 6-917570-X, 7-917570-X, 8-917570-X, 9-917570-X NO BOSS.
 △ 8-917570-X, 9-917570-X Au PLT. OTHER TIN-READ PLT.

ITEM NO.	名称 / MANE	材質 / MATERIAL
2	ヘッダー ハウジング HDR.HOUSING	46ナイロン(黒) 46NYLON 94V-0(BLACK)
7	リセ コンタクト REC. CONTACT	りん青銅 Ph-Br 1.27µm以上のNi下地めっきの上段に接触部0.2µm以上のAuめっき、タイン部Auフラッシュ FINISH UNDER Ni 1.27µm MIN, CONTACT AREA Au 0.2µm MIN, TINE AREA Au FLASH
7	リセ コンタクト REC. CONTACT	りん青銅 Ph-Br 1.27µm以上のNi下地めっきの上段全面2µm以上の鍍めっき FINISH UNDER Ni 1.27µm MIN, SURFACE Sn 2µm MIN

D2 REVISED PER ECO-11-005030				RK HMR 22MAR11				DR. 30/JUN/95 K.IKEGAMI				DE. 30/JUN/95 K.IKEGAMI				CHK. 03/JUL/95 I.HASEGAWA				APP. 03/JUL/95 I.HASEGAWA				TE Connectivity			
																								結合電線径(WIRE RANGE) mm?(AWG -) 絶縁径(INSULATION DIA.) mmφ 名称(NAME) ヘッダー アッセンブリ min VP 1.5mm WtoB コネクタ HDR Ass'y, mini VP 1.5mm WtoB CONN			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR CHK DATE				表参照 SEE TABLE				表参照 SEE TABLE				一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 100F : ±0.2 1000F : ±0.25 3000F : ±0.3 角 度 : ±3°				尺度(SCALE) 8-1 REV. D2 SHEET 1 OF 1							

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面